大神路協力条約に基づいて公開された国際出版 ROC'd

(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2004 年5 月21 日 (21.05.2004)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2004/041879 A1

(51) 国際特許分類7:

WO 2004/041879 A1

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2003/014051

(22) 国際出願日:

2003年11月4日(04.11.2003)

C08F 220/10, G03F 7/039

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2002-320697 2002年11月5日(05.11.2002) J 特願2002-330870

2002年11月14日 (14.11.2002) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): JSR 株式会社 (JSR CORPORATION) [JP/JP]; 〒104-8410 東京都中央区 築地五丁目 6番 1 0号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 石井 寛之 (ISHII,Hiroyuki) [JP/JP]; 〒104-8410 東京都 中央区 築地五丁目 6番 1 0号 J S R株式会社内 Tokyo (JP). 藤原 考一 (FUJIWARA,Kouichi) [JP/JP]; 〒104-8410 東京都 中央区 築地五丁目 6番 1 0号 J S R株式会社内 Tokyo (JP). 山口 宙志 (YAMAGUCHI,Hiroshi) [JP/JP]; 〒104-8410 東京都 中央区 築地五丁目 6番 1 0号 J S R株式会社内 Tokyo (JP). 西村 幸生 (NISHIMURA,Yukio) [JP/JP]; 〒104-8410 東京都中央

区 築地五丁目 6 番 1 0 号 J S R 株式会社内 Tokyo (JP).

- (74) 代理人: 和気操(WAKI,Misao); 〒511-0811 三重県桑 名市 畷町 6 2 5 番地 Mie (JP).
- (81) 指定国 (国内): AB, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

- 一 国際調査報告書
- 補正書・説明書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: ACRYLIC COPOLYMER AND RADIATION-SENSITIVE RESIN COMPOSITION

(54) 発明の名称: アクリル系共重合体および感放射線性樹脂組成物

(57) Abstract: An acrylic copolymer having a specific structure; and a composition containing the copolymer. The composition is highly transparent to radiations and is excellent in basic properties required of resists, such as sensitivity, resolution, resistance to dry etching, and pattern shape. It is highly suitable especially for use as a resist for forming contact holes and line spaces.

○ (57) 要約: 特定の構造を有するアクリル系共重合体、およびこの共重合体を用いることにより、放射線に対する透明性が高く、しかも感度、解像度、ドライエッチング耐性、パターン形状等のレジストとしての基本物性に優れ、特に、コンタクトホールおよびラインスペース形成時のレジストとして優れる。





明細書

アクリル系共重合体および感放射線性樹脂組成物

5 技術分野

10

15

20

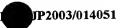
25

本発明はアクリル系共重合体および感放射線性樹脂組成物に関し、特にKrF エキシマレーザーあるいはArFエキシマレーザー等の遠紫外線、シンクロトロン放射線等のX線、電子線等の荷電粒子線の如き各種の放射線を使用する微細加工に有用な化学増幅型レジストとして好適に使用できる感放射線性樹脂組成物に関する。

背景技術

集積回路素子の製造に代表される微細加工の分野においては、より高い集積度を得るために、最近ではArFxキシマレーザー(波長193nm)、 F_2x キシマレーザ(波長157nm)等を用いた200nm程度以下のレベルでの微細加工が可能なリソグラフィー技術が必要とされている。このようなxキシマレーザーによる照射に適した感放射線性樹脂組成物として、酸解離性官能基を有する成分と放射線の照射により酸を発生する成分である酸発生剤とによる化学増幅効果を利用した化学増幅型感放射線性組成物が数多く提案されている。

例えば、感放射線性樹脂組成物に使用できる重合体として、ラクトン構造を有する (メタ) アクリレート重合体 (特許文献1参照)、特定の構造で表される脂環式基を有しかつその環骨格を構成する炭素原子の1個が適当な低級アルキル基で置換された部分を有する脱保護基あるいはその環骨格が他原子を1個以上経由してエステル結合している脱保護基を備えた化合物 (特許文献2参照)、2ーアルキルー2ーアダマンチル基、または1ーアダマンタンー1ーアルキルアダマンチル基で保護されたアルカリ可溶性を有し、それ自身ではアルカリに不溶または難溶であるが、酸の作用でアルカリに可溶となる樹脂と特定のスルホニウム塩系酸発生剤を含有する化学増幅型ポジ型レジスト組成物(特許文献3参照)。特定の基板密着性脂環式エステルと特定の脂環式骨格を有する酸脱離性のエス



テルに、第3成分として上記2成分の中間の極性を持つ特定の脂環式エステルを加えて3元共重合させたフォトレジスト用高分子化合物(特許文献4参照)、同じく脂環式骨格を有する特定構造の3種の単量体ユニットを特定の割合で含む樹脂(特許文献5参照)等が知られている。

5

10

15

しかしながら、半導体分野において、従来より高い集積度が求められるようになると、レジストである感放射線性樹脂組成物はより優れた解像度が必要とされるようになってきた。解像度を向上させ、形成されるパターン形状をより正確に描画するために、感放射線性樹脂組成物は種々組み合わせて使用されるようになる。例えば、コンタクトホールの形成とライン描画とを別々の感放射線性樹脂組成物を使用する場合がある。あるいは製造工程数を少なくするために一つの感放射線性樹脂組成物を使用する場合がある。また、より狭い径のコンタクトホールを形成するために、現像後のポストベークによりコンタクトホールパターンサイズを縮小させるサーマルフロー技術が用いられているが、ArFエキシマレーザー(波長193nm)、 F_2 エキシマレーザ(波長157nm)等を用いた200nm程度以下で使用される感放射線性樹脂組成物では、サーマルフロー技術に適した感放射線性樹脂組成物がないという問題がある。特に、コンタクトホールがより狭くなり、ラインスペースが狭くなると僅かなエッチング時の荒れが解像度に悪影響を及ぼすという問題がある。

20 【特許文献1】特許第3042618号公報(特許請求の範囲)

【特許文献2】特開平9-73173号公報(段落 [0137])

【特許文献3】特開2002-156750号公報(段落[0008])

【特許文献4】特開2002-145955号公報(段落[0008]および[0009])

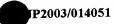
25 【特許文献 5 】特開 2 0 0 2 - 2 0 1 2 3 2 号公報 (段落 [0 0 0 9] および [0 0 1 0])

発明の開示

10

15

20



本発明は、このような問題に対処するためになされたもので、特定の構造を有するアクリル系共重合体、およびこの共重合体を用いることにより、放射線に対する透明性が高く、しかも感度、解像度、ドライエッチング耐性、パターン形状等のレジストとしての基本物性に優れ、特に、コンタクトホールおよびラインスペース形成に優れる感放射線性樹脂組成物の提供を目的とする。

本発明のアクリル系共重合体は、下記式(1)、式(2)および式(3)で表 される繰り返し単位を含むことを特徴とする。

式(2)において、Rは水素原子またはメチル基を表し、R¹は相互に独立に水素原子、水酸基、または $-COOR^3$ 基を表し、少なくとも $-OOR^1$ が水素原子ではなく、R³が水素原子あるいは炭素数 $1\sim 4$ の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基、または炭素数 $3\sim 2$ のの脂環式のアルキル基を表し、式(3)において、R²は相互に独立に炭素数 $4\sim 2$ のの1価の脂環式炭化水素基もしくはその誘導体または $1\sim 4$ の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基を表し、かつR²の少なくとも 1 つが該脂環式炭化水素基もしくはその誘導体であるか、あるいは何れか2 つの R²が相互に結合して、それぞれが結合している炭素原子とともに炭素数 $4\sim 2$ 0 の 2 価の脂環式炭化水素基もしくはその誘導体を形成し、残りの R²が炭素数 $1\sim 4$ の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基または炭素数 $4\sim 2$ 0 の 1 価の脂環式炭化水素基もしくはその誘導体を表す。



本発明の感放射線性樹脂組成物は、アルカリ不溶性またはアルカリ難溶性であって酸の作用によりアルカリ可溶性となる酸解離性基含有樹脂と、感放射線性酸発生剤とを含有し、該酸解離性基含有樹脂が上記式(1)、式(2)および式(3)で表される繰り返し単位を含むアクリル系共重合体であることを特徴とする。

5

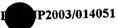
10

15

微細加工を必要とするリソグラフィー技術において、代表的なリソグラフィー工程としてラインアンドスペースおよびコンタクトホール形成工程がある。微細加工が必要になるにつれ、必ずしも両者を同一の感放射線性樹脂組成物でまかなえない状況になってきている。レジストとしての解像性能を追求した場合に、ラインアンドスペースはパターン全体の形状を重視し、コンタクトホールはパターン上部の形状を重視するためであると考えられている。これらの問題を克服するために種々検討した結果、メタアクリル酸系繰り返し単位とアクリル酸系繰り返し単位との両方を含有することにより、ラインアンドスペースおよびコンタクトホール形成において同一の感放射線性樹脂組成物にて良好なパターン形状が得られることが分かり、かつ広いプロセスマージンが得られることを見出した。また、繰り返し単位(3)として、一て(R²)。を特定の官能基側鎖に選択することで、今後微細化が進んだ場合に問題となる放射線処理後の加熱処理温度依存性も良好となることを見出した。本発明はこのような知見に基づくものである。

本発明のアクリル系共重合体を用いた感放射線性樹脂組成物は、活性放射線、特に、ArFエキシマレーザー(波長193nm)に代表される遠紫外線に感応する化学増幅型レジストとして、放射線に対する透明性、解像度、感度等が高くかつレジストパターン形状も良好であるレジストとしての基本的性能を有しているだけでなく、第一に、エッチング耐性、エッチングの表面荒れ耐性が極めて高く、第二に、ポストベークによるコンタクトホールサイズの調整をすることが可能である。また、ポストベーク温度変動による線幅変動を少なくできる。

発明を実施するための最良の形態



重合体主鎖を形成する式(1)で表される繰り返し単位を生じさせる単量体としては、式(1-1)で表されるメタアクリル酸エステルが挙げられる。

5

20

式 (2) において、Rは水素原子またはメチル基を表し、 R^1 は相互に独立に 水素原子、水酸基、または $-COOR^3$ 基を表す。ただし、少なくとも $-OOR^1$ が水素原子ではない。また、少なくとも $-OOR^1$ が水酸基であることが好まし い。

10 -COOR³基におけるR³としては、水素原子あるいは炭素数1~4の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基、または炭素数3~20の脂環式のアルキル基を表す。

炭素数 1~4の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基としては、メチル基、エチル基、n-プロピル基、i-プロピル基、n-ブチル基、2-メチルプロピル基、15・1-メチルプロピル基、 t-ブチル基を例示できる。

炭素数 $3\sim 20$ の脂環式のアルキル基としては、 $-C_nH_{2n-1}$ (n は $3\sim 20$ の整数)で表されるシクロアルキル基、例えば、シクロプロピル基、シクロブチル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、シクロヘプチル基、シクロオクチル基等が、また、多環型脂環式アルキル基、例えば、ビシクロ [2.2.1] ヘプチル基、トリシクロ $[5.2.1.0^{2.6}]$ デシル基、テトラシクロ $[6.2.1.1^{3.6}.0^{2.7}]$ ドデカニル基、アダマンチル基等、または、直鎖状、分岐状または環状のアルキル基の 1 種以上あるいは 1 個以上でシクロアルキル基または多環型脂環式アルキル基の一部を置換した基等が挙げられる。

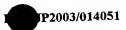


重合体主鎖を形成する式(2)で表される繰り返し単位を生じさせる単量体の 中で好ましい単量体を以下に挙げる。

(メタ) アクリル酸 3 - ヒドロキシアダマンタン-1-イルエステル、(メタ) アクリル酸3,5-ジヒドロキシアダマンタン-1-イルエステル、(メタ)ア 5 クリル酸3-ヒドロキシー5-カルボキシアダマンタン-1-イルエステル、 (メタ)アクリル酸3-ヒドロキシ-5-メトキシカルボニルアダマンタン-1 -イルエステル、(メタ) アクリル酸3-カルボキシアダマンタン-1-イルエ ステル、(メタ) アクリル酸3,5-ジカルボキシアダマンタン-1-イルエス テル、(メタ)アクリル酸3-カルボキシル-5-ヒドロキシアダマンタン-1 10 -イルエステル、(メタ)アクリル酸3-カルボキシル-5-メトキシカルボニ ルアダマンタン-1-イルエステル、(メタ)アクリル酸3-メトキシカルボニ ルアダマンタン-1-イルエステル、(メタ)アクリル酸3,5-ジメトキシカ ルボニルアダマンタン-1-イルエステル、(メタ)アクリル酸3-メトキシカ ルボニルー5ーヒドロキシアダマンタンー1ーイルエステル、(メタ)アクリル 15 酸3-メトキシカルボニル-5-カルボキシアダマンタン-1-イルエステル 等が挙げられる。

重合体主鎖を形成する式(2)で表される繰り返し単位を生じさせる単量体の中で特に好適な単量体としては、(メタ)アクリル酸3ーヒドロキシアダマンタン-1ーイルエステル、(メタ)アクリル酸3,5ージヒドロキシアダマンタン-1ーイルエステル、(メタ)アクリル酸3ーカルボキシアダマンタン-1ーイルエステル、(メタ)アクリル酸3,5ージカルボキシアダマンタン-1ーイルエステル、(メタ)アクリル酸3ーカルボキシルー5ーヒドロキシアダマンタンコーイルエステル、(メタ)アクリル酸3ーメトキシカルボニルー5ーヒドロキシアダマンタン-1ーイルエステル、(メタ)アクリル酸3ーメトキシカルボニルー5ーヒドロキシアダマンタン-1ーイルエステル等が挙げられる。

式 (3) において、 R^2 の炭素数 $4\sim20$ の 1 価の脂環式炭化水素基もしくはその誘導体、または少なくとも 1つが脂環式炭化水素基もしくはその誘導体であ

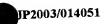


るか、あるいは何れか2つのR²が相互に結合して、それぞれが結合している炭素原子とともに炭素数4~20の2価の脂環式炭化水素基もしくはその誘導体としては、例えばビシクロ[2.2.1] ヘプタン、トリシクロ[5.2.1.0^{2.6}] デカン、テトラシクロ[6.2.1.1^{3.6}.0^{2.7}] ドデカン、シクロブタン、シクロペンタン、シクロヘキサン等のシクロアルカン類等に由来する脂環族環からなる基;これら脂環族環からなる基を例えば、メチル基、エチル基、ロープロピル基、iープロピル基、nーブチル基、2ーメチルプロピル基、1ーメチルプロピル基、tーブチル基等の炭素数1~4の直鎖状、分岐状または環状のアルキル基の1種以上あるいは1個以上で置換した基等が挙げられる。

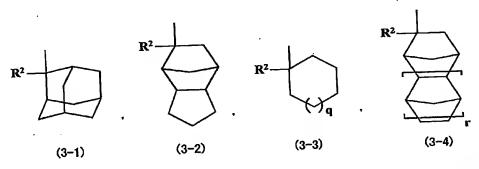
10 また、R²の1価または2価の脂環式炭化水素基の誘導体としては、例えば、ヒドロキシル基;カルボキシル基;オキシ基(即ち、=O基);ヒドロキシメチル基、1ーヒドロキシエチル基、2ーヒドロキシエチル基、1ーヒドロキシプロピル基、2ーヒドロキシプロピル基、2ーヒドロキシプロピル基、2ーヒドロキシブロピル基、2ーヒドロキシブチル基、3ーヒドロキシブチル基等の炭素数1~シブチル基、3ーヒドロキシブチル基、4ーヒドロキシブチル基等の炭素数1~4のヒドロキシアルキル基;メトキシ基、エトキシ基、ロープロポキシ基、iープロポキシ基、nーブトキシ基、2ーメチルプロポキシ基、1ーメチルプロポキシ基、tーブトキシ基等の炭素数1~4のアルコキシル基;シアノ基;シアノメチル基、2ーシアノエチル基、3ーシアノプロピル基、4ーシアノブチル基等の炭素数2~5のシアノアルキル基等の置換基を1種以上あるいは1個以上有する基が挙げられる。

これらの置換基のうち、ヒドロキシル基、カルボキシル基、ヒドロキシメチル 基、シアノ基、シアノメチル基等が好ましい。

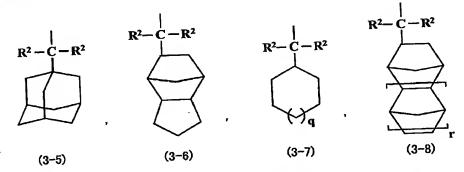
また、R²の炭素数1~4の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基としては、例 えば、メチル基、エチル基、nープロピル基、iープロピル基、nーブチル基、 25 2ーメチルプロピル基、1ーメチルプロピル基、tーブチル基等が挙げられる。 これらのアルキル基のうち、メチル基、エチル基、nープロピル基、iープロピル基が好ましい。



 $200R^2$ が相互に結合して、それぞれが結合している炭素原子とともに炭素数 $4\sim2002$ 価の脂環式炭化水素基もしくはその誘導体を形成している基の中で好ましい基としては、例えば下記式 $(3-1)\sim(3-4)$ で表される基が挙げられる。なお、各式中の R^2 は、脂環式炭化水素基もしくはその誘導体を形成する同一炭素に結合して、該炭素が主鎖あるいは側鎖の酸素に結合している形態を表している。qおよびrは $0\sim2$ の整数を表す。



また、各 R^2 が互いに独立に、少なくとも1つの R^2 が1価の炭素数 $4\sim20$ の 1価の脂環式炭化水素基形成した場合の好ましい骨格としては、例えば下記式 $(3-5)\sim(3-8)$ で表される基が挙げられる。qおよびrは $0\sim2$ の整数を表す。



これら、 R^2 が形成する1価の官能基側鎖としては、例えば以下の基が挙げられる。但し、以下に挙げる例示は、エステル結合の酸素に結合する-C (R^2) $_3$ を表したものである。

1-メチルー1-シクロペンチル基、1-エチルー1-シクロペンチル基、1-nープロピルー1-シクロペンチル基、1-iープロピルー1-シクロペンチル基、1-メチルー1-シクロヘキシル基、1-エチルー1-シクロヘキシル基、



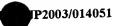
1-n-プロピル-1-シクロヘキシル基、1-i-プロピル-1-シクロヘキ シル基、2-メチルアダマンタン-2-イル基、2-メチル-3-ヒドロキシア ダマンタン-2-イル基、2-エチルチルアダマンタン-2-イル基、2-エチ ルー3ーヒドロキシアダマンタンー2ーイル基、2-n-プロピルアダマンタン -2-イル基、2-n-プロピル-3-ヒドロキシアダマンタン-2-イル基、 5 2ーイソプロピルアダマンタンー2ーイル基、2ーイソプロピルー3ーヒドロキ シアダマンタン-2-イル基、2-メチルビシクロ[2.2.1] ヘプター2-イル基、2-エチルビシクロ[2.2.1] ヘプター2-イル基、8-メチルト リシクロ $[5. 2. 1. 0^{2.6}]$ デカー8ーイル基、8ーエチルトリシクロ [5.2. 1. 0^{2,6}] デカー8ーイル基、4ーメチルーテトラシクロ [6. 2. 1. 1 10 3.6. 0^{2,7}] ドデカー4ーイル基、4ーエチルーテトラシクロ [6.2.1.1^{3,6}. 0^{2,7}] ドデカー4ーイル基、1ー(ビシクロ [2.2.1] ヘプター2ーイル) -1-メチルエチル基、1-(トリシクロ[5.2.1.0^{2,6}] デカー8-イル) -1-メチルエチル基、1- (テトラシクロ [6.2.1.1^{3,6}.0^{2,7}] デカー 4-イル) -1-メチルエチル基、1-(アダマンタン-1-イル) -1-メチ 15 ルエチル基、1-(3-ヒドロキシアダマンタン-1-イル)-1-メチルエチ ル基、1,1ージシクロヘキシルエチル基、1,1ージ(ビシクロ[2.2.1] ヘプター2ーイル) エチル基、1, 1ージ(トリシクロ[5.2.1.02,6]デ カー8ーイル)エチル基、1, 1ージ(テトラシクロ $[6.2.1.1^{3.6}.0^{2.7}]$ ドデカー4ーイル) エチル基、1, 1ージ (アダマンタン-1ーイル) エチル基 20 等が挙げられる。

また、上記の中で特に好ましい官能基側鎖 $-C(R^2)_3$ としては、1-メチルシクロペンチル基、1-エチル-1-シクロペンチル基、1-メチル-1-シクロヘキシル基が挙げられる。

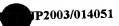
25

また、重合体主鎖を形成する式(3)で表される繰り返し単位を与える単量体 として好適な例を以下に挙げる。

アクリル酸1ーメチルー1ーシクロペンチルエステル、アクリル酸1ーエチル -1-シクロペンチルエステル、アクリル酸1-n-プロピルー1ーシクロペン



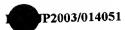
チルエステル、アクリル酸1-i-プロピル-1-シクロペンチルエステル、ア クリル酸1-メチル-1-シクロヘキシルエステル、アクリル酸1-エチル-1 ーシクロヘキシルエステル、アクリル酸1-n-プロピルー1-シクロヘキシル エステル、アクリル酸1-i-プロピル-1-シクロヘキシルエステル、アクリ ル酸2-メチルアダマンタン-2-イルエステル、アクリル酸2-メチル3-ヒ 5 ドロキシアダマンタンー2ーイルエステル、アクリル酸2ーエチルアダマンタン -2-イルエステル、アクリル酸2-エチル3-ヒドロキシアダマンタン-2-イルエステル、アクリル酸2-n-プロピルーアダマンタン-2-イルエステル、 アクリル酸2-n-プロピル3-ヒドロキシアダマンタン-2-イルエステル、 アクリル酸2-イソプロピルアダマンタン-2-イルエステル、アクリル酸2-10 イソプロピル3-ヒドロキシアダマンタン-2-イルエステル、アクリル酸2-メチルアダマンタン-2-イルエステル、アクリル酸2-メチルビシクロ[2. 2. 1] ヘプター2ーイルエステル、アクリル酸2ーエチルビシクロ[2.2. 1] ヘプター2ーイルエステル、アクリル酸8ーメチルトリシクロ[5.2.1. $0^{2,6}$] デカー8ーイルエステル、アクリル酸8ーエチルトリシクロ[5.2.1. 15 $0^{2,6}$] デカー8ーイルエステル、アクリル酸4-メチルテトラシクロ [6.2. 1. $1^{3,6}$. $0^{2,7}$] ドデカー4ーイルエステル、アクリル酸4ーエチルテトラシク ロ $[6.2.1.1^{3.6}.0^{2.7}]$ ドデカー4ーイルエステル、アクリル酸1-(ビ シクロ[2.2.1] ヘプター2ーイル) ー1ーメチルエステル、アクリル酸1 20 アクリル酸1- (テトラシクロ [6.2.1.13,6.02,7] ドデカー4ーイル) -1-メチルエチルエステル、アクリル酸1-(アダマンタン-1-イル)-1 ーメチルエチルエステル、アクリル酸1-(3-ヒドロキシアダマンタン-1-イル) -1-メチルエチルエステル、アクリル酸1, 1-ジシクロヘキシルエチ ルエステル、アクリル酸1,1-ジ(ビシクロ[2.2.1] ヘプター2ーイル) 25 エチルエステル、アクリル酸1, $1-ジ(トリシクロ[5.2.1.0^{2.6}]$ デカ 1.13.6.02.7] ドデカー4ーイル) エチルエステル、アクリル酸1,1ージ (ア ダマンタン-1-イル) エチルエステルが挙げられる。



上記重合体主鎖を形成する式(3)で表される繰り返し単位を与える単量体の中で、特に好適な単量体としては、アクリル酸1ーメチルー1ーシクロペンチルエステル、アクリル酸1ーエチルー1ーシクロペンチルエステル、アクリル酸1ーnープロピルー1ーシクロペンチルエステル、アクリル酸1ーメチルー1ーシクロヘキシルエステル、アクリル酸1ーエチルー1ーシクロヘキシルエステルが挙げられる。これらは単独でも混合しても使用できる。

本発明のアクリル系共重合体は、上記繰り返し単位(1)、繰り返し単位(2) および繰り返し単位(3)以外にさらに他の繰り返し単位を含むことができる。他の繰り返し単位を与える単量体としては、例えば、(メタ)アクリルアミド、N,Nージメチル(メタ)アクリルアミド、クロトンアミド、マレインアミド、フマルアミド、メサコンアミド、シトラコンアミド、イタコンアミド等の不飽和アミド化合物;メチレングリコールジ(メタ)アクリレート、エチレングリコールジ(メタ)アクリレート、2,5ージメチルー2,5ーヘキサンジオールジ(メタ)アクリレート、1,2ーアダマンタンジオールジ(メタ)アクリレート、1,3ーアダマンタンジオールジ(メタ)アクリレート、1,4ーアダマンタンジオールジ(メタ)アクリレート、トリシクロデカニルジメチロールジ(メタ)アクリレート等の多官能性単量体が20 挙げられる。

本発明のアクリル系共重合体は、上記繰り返し単位(1)、繰り返し単位(2) および繰り返し単位(3)で構成することが好ましく、その配合割合は、全繰り返し単位に対して、繰り返し単位(1)が20~70モル%、好ましくは30~60モル%;繰り返し単位(2)が5~40モル%、好ましくは5~25モル%;繰り返し単位(3)が20~50モル%、好ましくは30~45モル%である。繰り返し単位(1)の含有率が20モル%未満では、レジストとしての現像性が悪化する傾向にあり、繰り返し単位(1)の含有率が70モル%をこえると解像性の劣化およびレジスト溶媒への溶解性が低下する傾向にある。



繰り返し単位(2)の含有率が5モル%未満では、レジストとしての解像性が低下する傾向にあり、繰り返し単位(2)の含有率が40モル%をこえるとレジストとしての現像性が悪化する傾向にある。

繰り返し単位(3)の含有率が20モル%未満では、解像性が低下する傾向に 5 あり、繰り返し単位(3)の含有率が50モル%をこえると現像性が悪化する傾 向にある。

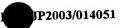
本発明のアクリル系共重合体は、例えば、各繰り返し単位に対応する単量体の 混合物を、ヒドロパーオキシド類、ジアルキルパーオキシド類、ジアシルパーオ キシド類、アゾ化合物等のラジカル重合開始剤を使用し、必要に応じて連鎖移動 剤の存在下、適当な溶媒中で重合することにより製造できる。

上記重合に使用される溶媒としては、例えば、シクロヘキサン、シクロヘプタン、シクロオクタン、デカリン、ノルボルナン等のシクロアルカン類;酢酸エチル、酢酸 n ーブチル、酢酸 i ーブチル、プロピオン酸メチル、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート等の飽和カルボン酸エステル類;γーブチロラクトン等のアルキルラクトン類;2ーブタノン、2ーヘプタノン、メチルイソブチルケトン等のアルキルケトン類;シクロヘキサノン等のシクロアルキルケトン類;2ープロパノール、プロピレングリコールモノメチルエーテル等のアルコール類等が挙げられる。

20 これらの溶媒は、単独でまたは2種以上を混合して使用できる。

また、上記重合における反応温度は、通常、 $40\sim120$ $\mathbb C$ 、好ましくは $50\sim100$ $\mathbb C$ であり、反応時間は、通常、 $1\sim48$ 時間、好ましくは $1\sim24$ 時間である。

25 本発明のアクリル系共重合体は、ハロゲン、金属等の不純物が少ないのは当然のことながら、残留単量体やオリゴマー成分が既定値以下、例えばHPLCで O. 1 重量%等であることが好ましく、それにより、レジストとしての感度、解像度、プロセス安定性、パターン形状等をさらに改善できるだけでなく、液中異物や感度等の経時変化がないレジストが得られる。



アクリル系共重合体の精製法としては、例えば以下の方法が挙げられる。金属等の不純物を除去する方法としては、ゼータ電位フィルターを用いて樹脂溶液中の金属を吸着させる方法や蓚酸やスルホン酸等の酸性水溶液で樹脂溶液を洗浄することで金属をキレート状態にして除去する方法等が挙げられる。また、残留 単量体やオリゴマー成分を規定値以下に除去する方法としては、水洗や適切な溶媒を組み合わせることにより残留単量体やオリゴマー成分を除去する液々抽出法、特定の分子量以下のもののみを抽出除去する限外口過等の溶液状態での精製方法や、アクリル系共重合体溶液を貧溶媒へ滴下することで重合体を貧溶媒中に凝固させることにより残留単量体等を除去する再沈澱法やろ別した重合体スラリーを貧溶媒で洗浄する等の固体状態での精製方法がある。また、これらの方法を組み合わせることもできる。上記再沈澱法に用いられる貧溶媒としては、精製するアクリル系共重合体の物性等に左右され一概には例示することはできない。適宜、貧溶媒は選定されるものである。

アクリル系共重合体のゲルパーミエーションクロマトグラフィ(GPC)によるポリスチレン換算重量平均分子量(以下、「Mw」という。)は、通常、1,000~300,000、好ましくは2,000~200,000、さらに好ましくは3,000~100,000である。この場合、アクリル系共重合体のMwが1,000未満では、レジストとしての耐熱性が低下する傾向があり、一方300,000をこえると、レジストとしての現像性が低下する傾向がある。

また、アクリル系共重合体のMwとゲルパーミエーションクロマトグラフィ (GPC) によるポリスチレン換算数平均分子量(以下、「Mn」という。)との比(Mw/Mn)は、通常、 $1\sim5$ 、好ましくは $1\sim3$ である。

本発明において、MwおよびMnは東ソー (株) 製GPCカラム (G2000 25 HXL 2本、G3000HXL 1本、G4000HXL 1本) を用い、流量 1.0ml/分、溶出溶媒テトラヒドロフラン、カラム温度40℃の分析条件で、 単分散ポリスチレンを標準とするゲルパーミエーションクロマトグラフィ(GPC) により測定した。



本発明において、アクリル系共重合体は、単独でまたは2種以上を混合して使用できる。

また、このアクリル系共重合体はアルカリ不溶性またはアルカリ難溶性であるが、酸の作用によりアルカリ可溶性となる。そのため、感放射線性樹脂組成物に 用いられる酸解離性基含有樹脂として好適である。

上記アクリル系共重合体を酸解離性基含有樹脂として用い、放射線の照射により酸を発生する成分である酸発生剤と組み合わせることにより感放射線性樹脂 組成物が得られる。

10 酸発生剤としては、スルホニウム塩やヨードニウム塩等のオニウム塩、有機ハロゲン化合物、ジスルホン類やジアゾメタンスルホン類等のスルホン化合物を挙 げることができる。

酸発生剤として好ましいものとしては、トリフェニルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、トリフェニルスルホニウムノナフルオローnーブタンスルホネート、トリフェニルスルホニウムパーフルオローnーオクタンスルホネート、トリフェニルスルホニウム2ービシクロ [2.2.1] ヘプター2ーイルー1,1,2,2ーテトラフルオロエタンスルホネート、トリフェニルスルホニウム2ー(3ーテトラシクロ [4.4.0.1².5.1³.10] ドデカニル)ー1,1ージフルオロエタンスルホネート、トリフェニルスル

20 ホニウムN, N'ービス (ノナフルオローnーブタンスルホニル) イミデート、 トリフェニルスルホニウムカンファースルホネート等のトリフェニルスルホニ ウム塩化合物;

4ーシクロヘキシルフェニルジフェニルスルホニウムトリフルオロメタンス

ルホネート、4ーシクロヘキシルフェニルジフェニルスルホニウムノナフルオローローブタンスルホネート、4ーシクロヘキシルフェニルジフェニルスルホニウムパーフルオローローオクタンスルホネート、4ーシクロヘキシルフェニルジフェニルスルホニウム2ービシクロ[2.2.1]ヘプター2ーイルー1,1,2,2ーテトラフルオロエタンスルホネート、4ーシクロヘキシルフェニルジフェニ



4-t-ブチルフェニルジフェニルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、4-t-ブチルフェニルジフェニルスルホニウムノナフルオローローブタンスルホネート、4-t-ブチルフェニルジフェニルスルホニウムパーフルオ10 ローローオクタンスルホネート、4-t-ブチルフェニルジフェニルジフェニルスルホニウム2ービシクロ[2.2.1] ヘプター2ーイルー1,1,2,2ーテトラフルオロエタンスルホネート、4-t-ブチルフェニルジフェニルスルホニウム2ー(3ーテトラシクロ[4.4.0.1².5.1².10] ドデカニル)ー1,1ージフルオロエタンスルホネート、4-t-ブチルフェニルジフェニルスルホニウムN,15 N'ービス(ノナフルオローローブタンスルホニル)イミデート、4-t-ブチルフェニルジフェニルスルホニウムカンファースルホネート等の4-t-ブチルフェニルジフェニルスルホニウム塩化合物;

トリ (4-t-ブチルフェニル) スルホニウムトリフルオロメタンスルホネー20 ト、トリ (4-t-ブチルフェニル) スルホニウムノナフルオローnーブタンスルホネート、トリ (4-t-ブチルフェニル) スルホニウムパーフルオローnーオクタンスルホネート、トリ (4-t-ブチルフェニル) スルホニウム 2ービシクロ [2.2.1] ヘプター2ーイルー1, 1, 2, 2ーテトラフルオロエタンスルホネート、トリ (4-t-ブチルフェニル) スルホニウム 2ー (3ーテトラシクロ [4.4.0.1².5.1³.10] ドデカニル)ー1, 1ージフルオロエタンスルホネート、トリ (4-t-ブチルフェニル) スルホニウムN, N'ービス (ノナフルオローnーブタンスルホニル) イミデート、トリ (4-t-ブチルフェニル) スルホニウムカンファースルホネート等のトリ (4-t-ブチルフェニル)スルホニウム塩化合物;



ジフェニルヨードニウムトリフルオロメタンスルホネート、ジフェニルヨードニウムパーフルオローnーブタンスルホネート、ジフェニルヨードニウムパーフルオローnーオクタンスルホネート、ジフェニルヨードニウム 2 ービシクロ[2.5.1] ヘプター2ーイルー1, 1, 2, 2ーテトラフルオロエタンスルホネート、ジフェニルヨードニウム 2 ー (3ーテトラシクロ [4.4.0.1².5.1².10] ドデカニル)ー1, 1ージフルオロエタンスルホネート、ジフェニルヨードニウムN, N'ービス (ノナフルオローnーブタンスルホニル) イミデート、ジフェニルヨードニウムカンファースルホネート等のジフェニルヨードニウム塩化合物;

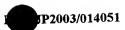
ビス (4-t-)チルフェニル)ョードニウムトリフルオロメタンスルホネート、ビス (4-t-)チルフェニル)ョードニウムノナフルオローn-プタンスルホネート、ビス (4-t-)プチルフェニル)ョードニウムパーフルオローn-15 オクタンスルホネート、ビス (4-t-)プチルフェニル)ョードニウム 2-ビシクロ [2. 2. 1] ヘプター2-イルー1, 1, 2, 2-テトラフルオロエタンスルホネート、ビス (4-t-)プチルフェニル)ョードニウム 2- (3- 7- 17-10 1

1-(4-n-ブトキシナフタレン-1-イル) テトラヒドロチオフェニウム
トリフルオロメタンスルホネート、1-(4-n-ブトキシナフタレン-1-イル) テトラヒドロチオフェニウムノナフルオロ-n-ブタンスルホネート、1(4-n-ブトキシナフタレン-1-イル) テトラヒドロチオフェニウムパーフ
ルオロ-n-オクタンスルホネート、1-(4-n-ブトキシナフタレン-1イル) テトラヒドロチオフェニウム2-ビシクロ[2.2.1] ヘプタ-2-イ



ルー1, 1, 2, 2ーテトラフルオロエタンスルホネート、1-(4-n-j)トキシナフタレンー1-iイル) テトラヒドロチオフェニウム2-(3-j)クロ $[4.4.0.1^{2.5}.1^{7.10}]$ ドデカニル) -1, 1-iジフルオロエタンスルホネート、1-(4-n-j)トキシナフタレンー1-iイル) テトラヒドロチオフェニウムN, 1-i (ノナフルオロー1-i) テトラヒドロチオフェニウムカン -(4-n-j)トキシナフタレンー1-iル) テトラヒドロチオフェニウムカンファースルホネート等の1-(4-n-j)トキシナフタレンー1-iル) テトラヒドロチオフェニウム塩化合物;

- 1-(3,5-ジメチル-4-ヒドロキシフェニル)テトラヒドロチオフェニ 10 ウムトリフルオロメタンスルホネート、1-(3,5-ジメチル-4-ヒドロキ シフェニル)テトラヒドロチオフェニウムノナフルオローn-ブタンスルホネー ト、1-(3,5-ジメチル-4-ヒドロキシフェニル)テトラヒドロチオフェ ニウムパーフルオローnーオクタンスルホネート、1-(3,5-ジメチルー4 ーヒドロキシフェニル) テトラヒドロチオフェニウム2ービシクロ[2.2.1] 15 ヘプター2ーイルー1, 1, 2, 2ーテトラフルオロエタンスルホネート、1ー (3,5-ジメチルー4ーヒドロキシフェニル)テトラヒドロチオフェニウム2 - (3ーテトラシクロ $[4.4.0.1^{2.5}.1^{7.10}]$ ドデカニル)-1, 1 -ジフ ルオロエタンスルホネート、1-(3,5-ジメチル-4-ヒドロキシフェニル) テトラヒドロチオフェニウムN, N'ービス (ノナフルオローnーブタンスルホ 20 ニル) イミデート、1-(3,5-ジメチル-4-ヒドロキシフェニル) テトラ ヒドロチオフェニウムカンファースルホネート等の1-(3,5-ジメチルー4 ーヒドロキシフェニル)テトラヒドロチオフェニウム塩化合物;
 - 25 N- (\(\begin{aligned} \quad \mathbb{N} (\beta \beta \chi \chi \nu \rangle \nu \



ドデカニル) -1, 1-ジフルオロエタンスルホニルオキシ) スクシンイミド、 <math>N-(カンファースルホニルオキシ) スクシンイミド等のスクシンイミド類化合物;

N-(トリフルオロメタンスルホニルオキシ) ビシクロ [2.2.1] ヘプタ 5 -5-エン-2, 3-ジカルボキシイミド、N-(ノナフルオロ-n-ブタンス ルホニルオキシ) ビシクロ [2.2.1] ヘプター5ーエンー2,3ージカルボ キシイミド、N - (パーフルオロ-n-オクタンスルホニルオキシ)ビシクロ[2. 2. 1] ヘプター5-エンー2, 3-ジカルボキシイミド、N-(2-ビシクロ [2.2.1] ヘプター2ーイルー1, 1, 2, 2ーテトラフルオロエタンスル 10 ホニルオキシ) ビシクロ [2.2.1] ヘプター5ーエンー2, 3ージカルボキ シイミド、 $N-(2-(3-テトラシクロ [4.4.0.1^{2,5}.1^{7,10}]$ ドデカ ニル)-1, 1-ジフルオロエタンスルホニルオキシ) ビシクロ [2.2.1] ヘプター5-エンー2,3-ジカルボキシイミド、N-(カンファースルホニル オキシ) ビシクロ[2.2.1] ヘプター5ーエンー2,3ージカルボキシイミ 15 ド等のビシクロ[2.2.1] ヘプター5ーエンー2,3ージカルボキシイミド 類化合物等が挙げられる。

これらの中で、さらに好ましくはトリフェニルスルホニウム塩化合物、4ーシ 20 クロヘキシルフェニルジフェニルスルホニウム塩化合物、4ーtーブチルフェニ ルジフェニルスルホニウム塩化合物およびトリ(4ーtーブチルフェニル)スル ホニウム塩化合物である。

本発明において、酸発生剤は、単独でまたは2種以上を混合して使用できる。酸発生剤の使用量は、レジストとしての感度および現像性を確保する観点から、アクリル系共重合体100重量部に対して、通常、0.1~20重量部、好ましくは0.1~7重量部である。この場合、酸発生剤の使用量が0.1重量部未満では、感度および現像性が低下する傾向があり、一方20重量部をこえると、放

20

25



射線に対する透明性が低下して、矩形のレジストパターンを得られ難くなる傾向 がある。

本発明の感放射線性樹脂組成物には、必要に応じて、酸拡散制御剤、酸解離性 基を有する脂環族添加剤、酸解離性基を有しない脂環族添加剤、界面活性剤、増 感剤等の各種の添加剤を配合できる。

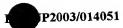
上記酸拡散制御剤は、照射により酸発生剤から生じる酸のレジスト被膜中における拡散現象を制御し、非照射領域における好ましくない化学反応を抑制する作用を有する成分である。

10 このような酸拡散制御剤を配合することにより、得られる感放射線性樹脂組成物の貯蔵安定性が向上し、またレジストとしての解像度がさらに向上するとともに、照射から現像処理までの引き置き時間(PED)の変動によるレジストパターンの線幅変化を抑えることができ、プロセス安定性に極めて優れた組成物が得られる。

15 上記酸拡散制御剤としては、レジストパターンの形成工程中の照射や加熱処理 により塩基性が変化しない含窒素有機化合物が好ましい。

このような含窒素有機化合物としては、「3級アミン化合物」、「アミド基含有化合物」、「4級アンモニウムヒドロキシド化合物」、「含窒素複素環化合物」等が挙げられる。

「3級アミン化合物」としては、例えば、トリエチルアミン、トリーnープロピルアミン、トリーnープチルアミン、トリーnーペンチルアミン、トリーnーペンチルアミン、トリーnーペキシルアミン、トリーnースクチルアミン、トリーnーオクチルアミン、トリーnーノニルアミン、トリーnーデシルアミン、シクロヘキシルジメチルアミン、ジシクロヘキシルメチルアミン、トリシクロヘキシルアミン等のトリ(シクロ)アルキルアミン類;アニリン、Nーメチルアニリン、N,Nージメチルアニリン、2ーメチルアニリン、3ーメチルアニリン、4ーメチルアニリン、4ーニトロアニリン、2,6ージメチルアニリン、ジフェニルアミン、トリフェニルアミン、ナフチルアミン等の芳香族アミン類;トリエ



タノールアミン、ジエタノールアニリンなどのアルカノールアミン類; N, N, N', N'ーテトラメチルエチレンジアミン、N, N, N', N'ーテトラキス(2ーヒドロキシプロピル) エチレンジアミン、1, 3ービス[1ー(4ーアミノフェニル)ー1ーメチルエチル] ベンゼンテトラメチレンジアミン、2, 2ービス(4ーアミノフェニル) プロパン、2ー(3ーアミノフェニル)ー2ー(4ーアミノフェニル) プロパン、2ー(4ーアミノフェニル)ー2ー(3ーヒドロキシフェニル) プロパン、2ー(4ーアミノフェニル)ー2ー(4ーヒドロキシフェニル) プロパン、1, 4ービス[1ー(4ーアミノフェニル)ー1ーメチルエチル]ベンゼン、1, 3ービス[1ー(4ーアミノフェニル)ー1ーメチルエチル]ベンゼン、1, 3ービス[1ー(4ーアミノフェニル)ー1ーメチルエチル] ベンゼン、ビス(2ージメチルアミノエチル) エーテル、ビス(2ージエチルアミノエチル) エーテル、ビス(2ージエチルアミノエチル) エーテル、ビス(2ージエチルアミノエチル) エーテル等が挙げられる。

「アミド基含有化合物」としては、例えば、N-t-ブトキシカルボニルジー n-オクチルアミン、N-t-ブトキシカルボニルジ-n-ノニルアミン、Nt-ブトキシカルボニルジーn-デシルアミン、N-t-ブトキシカルボニルジ 15 シクロヘキシルアミン、N-t-ブトキシカルボニル-1-アダマンチルアミン、 N-t-ブトキシカルボニル-N-メチル-1-アダマンチルアミン、N, N-ジーtーブトキシカルボニルー1ーアダマンチルアミン、N, Nージーtーブト キシカルボニル-N-メチル-1-アダマンチルアミン、N-t-ブトキシカル ボニルー4, 4'ージアミノジフェニルメタン、N, N'ージーtーブトキシカル 20 ボニルヘキサメチレンジアミン、N, N, N', N'ーテトラー t ーブトキシカル ボニルヘキサメチレンジアミン、N, N'ージー t ープトキシカルボニルー1, 7-ジアミノヘプタン、N, N'-ジ-t-ブトキシカルボニルー1, 8-ジア ミノオクタン、N, N'ージー t ーブトキシカルボニルー1, 9 ージアミノノナ ン、N, N'ージー t ープトキシカルボニルー1, 10ージアミノデカン、N, 25 N'ージーtープトキシカルボニルー1,12ージアミノドデカン、N,N'ージ - t ーブトキシカルボニルー 4, 4'ージアミノジフェニルメタン、N-tーブ トキシカルボニルベンズイミダゾール、N-t-ブトキシカルボニルー2-メチ ルベンズイミダゾール、N-t-ブトキシカルボニル-2-フェニルベンズイミ



ダゾール等のN-t-ブトキシカルボニル基含有アミノ化合物のほか、ホルムアミド、N-メチルホルムアミド、N, N-ジメチルホルムアミド、アセトアミド、N-メチルアセトアミド、プロピオンアミド、ベンズアミド、ピロリドン、N-メチルピロリドン等が挙げられる。

5

25

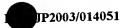
「4級アンモニウムヒドロキシド化合物」としては、例えば、テトラメチルアンモニウムヒドロキシド、テトラエチルアンモニウムヒドロキシド、テトラーnープロピルアンモニウムヒドロキシド、テトラーnーブチルアンモニウムヒドロキシド等が挙げられる。

「含窒素複素環化合物」としては、例えば、イミダゾール、4ーメチルイミダゾール、1ーベンジルー2ーメチルイミダゾール、4ーメチルー2ーフェニルイミダゾール、ベンズイミダゾール、2ーフェニルベンズイミダゾール等のイミダゾール類;ピリジン、2ーメチルピリジン、4ーメチルピリジン、2ーエチルピリジン、4ーエチルピリジン、2ーフェニルピリジン、4ーフェニルピリジン、4ーフェニルピリジン、4ーフェニルピリジン、4ーフェニルピリジン、キーフェニルピリジン、コーチン、ニコチン酸、ニコチン酸アミド、キノリン、4ーヒドロキシキノリン、8ーオキシキノリン、アクリジン等のピリジン類;ピペラジン、1ー(2ーヒドロキシエチル)ピペラジン等のピペラジン類のほか、ピラジン、ピラゾール、ピリダジン、キノザリン、プリン、ピロリジン、ピペリジン、3ーピペリジノー1,2ープロパンジオール、モルホリン、4
 マメチルモルホリン、1,4ージメチルピペラジン、1,4ージアザビシクロ[2.

2. 2]オクタン等が挙げられる。

上記含窒素複素環化合物のうち、3級アミン化合物、アミド基含有化合物、含窒素複素環化合物が好ましく、また、アミド基含有化合物の中ではN-t-ブトキシカルボニル基含有アミノ化合物が好ましく、含窒素複素環化合物の中ではイミダゾール類が好ましい。

上記酸拡散制御剤は、単独でまたは2種以上を混合して使用できる。酸拡散制御剤の配合量は、アクリル系共重合体100重量部に対して、通常、15重量部

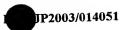


以下、好ましくは10重量部以下、さらに好ましくは0.001~5重量部である。この場合、酸拡散制御剤の配合量が15重量部をこえると、レジストとしての感度および放射線照射部の現像性が低下する傾向がある。なお、酸拡散制御剤の配合量が0.001重量部未満であると、プロセス条件によってはレジストとしてのパターン形状や寸法忠実度が低下するおそれがある。

また、酸解離性基を有する脂環族添加剤、または酸解離性基を有しない脂環族添加剤は、ドライエッチング耐性、パターン形状、基板との接着性等をさらに改善する作用を示す成分である。

このような脂環族添加剤としては、例えば、1-アダマンタンカルボン酸 t-10 ブチル、1 - アダマンタンカルボン酸 t - ブトキシカルボニルメチル、1 - アダ マンタンカルボン酸 lpha ブチロラクトンエステル、1,3ーアダマンタンジカル ボン酸ジー t ーブチル、1 ーアダマンタン酢酸 t ーブチル、1 ーアダマンタン酢 酸 t ーブトキシカルボニルメチル、1,3-アダマンタンジ酢酸ジー t ーブチル、 2,5-ジメチル-2,5-ジ(アダマンチルカルボニルオキシ)へキサン等の 15 アダマンタン誘導体類;デオキシコール酸 t ーブチル、デオキシコール酸 t ーブ トキシカルボニルメチル、デオキシコール酸2-エトキシエチル、デオキシコー ル酸2-シクロヘキシルオキシエチル、デオキシコール酸3-オキソシクロヘキ シル、デオキシコール酸テトラヒドロピラニル、デオキシコール酸メバロノラク トンエステル等のデオキシコール酸エステル類;リトコール酸 t ーブチル、リト 20 コール酸tーブトキシカルボニルメチル、リトコール酸2-エトキシエチル、リ トコール酸2-シクロヘキシルオキシエチル、リトコール酸3-オキソシクロヘ キシル、リトコール酸テトラヒドロピラニル、リトコール酸メバロノラクトンエ ステル等のリトコール酸エステル類;アジピン酸ジメチル、アジピン酸ジエチル、 アジピン酸ジプロピル、アジピン酸ジューブチル、アジピン酸ジェーブチル等の 25 アルキルカルボン酸エステル類等が挙げられる。

これらの脂環族添加剤は、単独でまたは2種以上を混合して使用できる。脂環 族添加剤の配合量は、アクリル系共重合体100重量部に対して、通常、50重



量部以下、好ましくは30重量部以下である。この場合、酸拡散制御剤の配合量が50重量部をこえると、レジストとしての耐熱性が低下する傾向がある。

また、上記界面活性剤は、塗布性、ストリエーション、現像性等を改良する作 5 用を示す成分である。

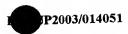
このような界面活性剤としては、例えば、ポリオキシエチレンラウリルエーテル、ポリオキシエチレンステアリルエーテル、ポリオキシエチレンオレイルエーテル、ポリオキシエチレンローオクチルフェニルエーテル、ポリオキシエチレンローノニルフェニルエーテル、ポリエチレングリコールジラウレート、ポリエチレングリコールジステアレート等のノニオン系界面活性剤のほか、以下商品名で、KP341(信越化学工業(株)製)、ポリフローNo.75,同No.95(共業社化学(株)製)、エフトップEF301,同EF303,同EF352(トーケムプロダクツ(株)製)、メガファックスF171,同F173(大日本インキ化学工業(株)製)、フロラードFC430,同FC431(住友スリーエンキ化学工業(株)製)、アサヒガードAG710,サーフロンS-382,同SC-101,同SC-102,同SC-103,同SC-104,同SC-105,同SC-106(旭硝子(株)製)等が挙げられる。

これらの界面活性剤は、単独でまたは2種以上を混合して使用できる。界面活性剤の配合量は、アクリル系共重合体100重量部に対して、通常、2重量部以下である。

また、上記増感剤は、放射線のエネルギーを吸収して、そのエネルギーを酸発生剤に伝達し、それにより酸の生成量を増加する作用を示すもので、感放射線性樹脂組成物のみかけの感度を向上させる効果を有する。

25 このような増感剤としては、例えば、カルバゾール類、ベンゾフェノン類、ローズベンガル類、アントラセン類、フェノール類等が挙げられる。

これらの増感剤は、単独でまたは2種以上を混合して使用できる。増感剤の配合量は、アクリル系共重合体100重量部に対して、好ましくは50重量部以下である。

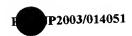


さらに、上記以外の添加剤としては、ハレーション防止剤、接着助剤、保存安 定化剤、消泡剤等が挙げられる。

本発明の感放射線性樹脂組成物は、普通、その使用に際して、全固形分濃度が、通常、3~50重量%、好ましくは5~25重量%となるように、アクリル系共重合体および酸発生剤等を溶剤に溶解したのち、例えば孔径200nm程度のフィルターでろ過し組成物溶液として調製される。

上記組成物溶液の調製に使用される溶剤としては、例えば、2ーペンタノン、 2-ヘキサノン、2-ヘプタノン、2-オクタノン等の直鎖状もしくは分岐状の ケトン類;シクロペンタノン、シクロヘキサノン等の環状のケトン類;プロピレ 10 ングリコールモノメチルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノエチル エーテルアセテート等のプロピレングリコールモノアルキルエーテルアセテー ト類;2-ヒドロキシプロピオン酸メチル、2-ヒドロキシプロピオン酸エチル 等の2-ヒドロキシプロピオン酸アルキル類;3-メトキシプロピオン酸メチル、 3-メトキシプロピオン酸エチル、3-エトキシプロピオン酸メチル、3-エト 15 キシプロピオン酸エチル等の3-アルコキシプロピオン酸アルキル類のほか、エ チレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテル、 ジエチレングリコールジメチルエーテル、ジエチレングリコールジエチルエーテ ル、エチレングリコールモノメチルエーテルアセテート、エチレングリコールモ ノエチルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロ 20ピレングリコールモノエチルエーテル、酢酸 n ーブチル、ピルビン酸メチル、ピ ルビン酸エチル、Nーメチルピロリドン、γーブチロラクトン等が挙げられる。

これらの溶剤は、単独でまたは2種以上を混合して使用できるが、プロピレン 25 グリコールモノメチルエーテルアセテート、2ーヘプタノン、シクロヘキサノン、 yーブチロラクトン、2ーヒドロキシプロピオン酸エチル、3ーエトキシプロピオン酸エチルから選ばれる少なくとも1種を含有することが好ましい。



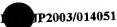
本発明の感放射線性樹脂組成物は、特に化学増幅型レジストとして有用である。 特にコンタクトホールを形成するためのレジストとして有用である。

化学増幅型レジストにおいては、放射線照射により酸発生剤から発生した酸の 作用によって、樹脂中の酸解離性基が解離して、カルボキシル基を生じ、その結び 果、レジストの照射部のアルカリ現像液に対する溶解性が高くなり、該照射部が アルカリ現像液によって溶解、除去され、ポジ型のレジストパターンが得られる。 本発明の感放射線性樹脂組成物からレジストパターンを形成する際には、組成 物溶液を、回転塗布、流延塗布、ロール塗布等の適宜の塗布手段によって、例え ば、シリコンウエハー、アルミニウムで被覆されたウエハー等の基板上に塗布す ることにより、レジスト被膜を形成し、場合により予め加熱処理(以下、「PB」 10 という。)を行なったのち、所定のレジストパターンを形成するように該レジス ト被膜に照射する。その際に使用される放射線としては、例えば、紫外線、Kr Fエキシマレーザー (波長248nm)、ArFエキシマレーザー (波長193 nm) 、 F_2 エキシマレーザー(波長157nm)、EUV(極紫外線、波長1 3 n m等)等の遠紫外線、電子線等の荷電粒子線、シンクロトロン放射線等のX 15 線等を適宜選択して使用できるが、これらのうち遠紫外線、電子線が好ましい。 また、照射量等の照射条件は、感放射線性樹脂組成物の配合組成、各添加剤の種 類等に応じて、適宜選定される。

本発明においては、高精度の微細パターンを安定して形成するために、照射後に加熱処理 (以下、「PEB」という。)を行なうことが好ましい。このPEBにより、樹脂 (A) 中の酸解離性有機基の解離反応が円滑に進行する。PEBの加熱条件は、感放射線性樹脂組成物の配合組成によって変わるが、通常、30~. 200℃、好ましくは50~170℃である。

本発明の感放射線性樹脂組成物は、PEB、現像後さらにポストベークするこ 25 とにより、コンタクトホールパターンサイズを精度良く縮小させることができる。

本発明においては、感放射線性樹脂組成物の潜在能力を最大限に引き出すため、 例えば特公平6-12452号公報等に開示されているように、使用される基板 上に有機系あるいは無機系の反射防止膜を形成しておくこともでき、また環境雰



囲気中に含まれる塩基性不純物等の影響を防止するため、例えば特開平5-18 8598号公報等に開示されているように、レジスト被膜上に保護膜を設けることもでき、あるいはこれらの技術を併用することもできる。

次いで、照射されたレジスト被膜をアルカリ現像液を用いて現像することにより、所定のレジストパターンを形成する。

上記アルカリ現像液としては、例えば、テトラメチルアンモニウムヒドロキシドを溶解したアルカリ性水溶液が好ましい。

上記アルカリ性水溶液の濃度は、通常、10重量%以下である。この場合、アルカリ性水溶液の濃度が10重量%をこえると、非照射部も現像液に溶解するおそれがあり好ましくない。

また、上記アルカリ性水溶液には、界面活性剤等を適量添加することもできる。 なお、アルカリ現像液で現像したのちは、一般に、水で洗浄して乾燥する。

実施例1

5

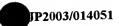
10

15

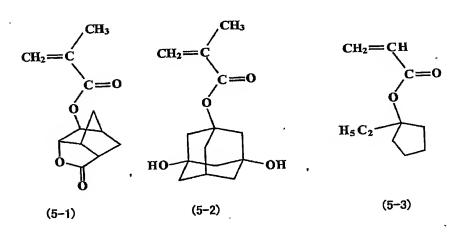
20

$$CH_{2} = C$$
 $CH_{2} = C$
 $CH_{2} = CH$
 $C=0$
 $C=0$

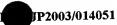
化合物 (4-1) 55.00g (50モル%)、化合物 (4-2) 11.70g (10モル%)、化合物 (4-3) 33.31g (40モル%)を2ーブタノン200gに溶解し、さらにジメチルアゾビスイソブチレート4.56gを投入した単量体溶液を準備し、100gの2ーブタノンを投入した1000mlの三口フラスコを30分窒素パージする。窒素パージの後、反応釜を攪拌しながら80℃に加熱し、事前に準備した上記単量体溶液を滴下漏斗を用いて4時間かけて滴下した。滴下開始を重合開始時間とし、重合反応を6時間実施した。重合終了



実施例2



化合物 (5-1) 54.57g (50 モル%)、化合物 (5-2) 12.39g (10 モル%)、化合物 (5-3) 33.04g (40 モル%)を2ーブタノン200gに溶解し、さらにジメチルアゾビスイソブチレート4.52gを投入した単量体溶液を準備し、100gの2ーブタノンを投入した1000mlの三ロフラスコを30分室素パージする。窒素パージの後、反応釜を攪拌しながら80℃に加熱し、事前に準備した上記単量体溶液を滴下漏斗を用いて4時間かけて滴下した。滴下開始を重合開始時間とし、重合反応を6時間実施した。重合終了後、重合溶液は水冷することにより30℃以下に冷却し、2ープロパノール/nーへプタン=1/2の混合溶媒2000gへ投入し、析出した白色粉末をろ別す



る。ろ別された白色粉末を2度2-プロパノール/n-ヘプタン=1/2の混合溶媒400gにてスラリー上で洗浄した後、5別し、50Cにて17時間乾燥し、白色粉末の重合体を得た(69g、収率69%)。この重合体はMwが8900であり、化合物(5-1)、化合物(5-2)、化合物(5-3)で表される繰り返し単位、各繰り返し単位の含有率が 13 C NMRで測定した結果、53.3:10.8:35.9 (モル%)の共重合体であった。この共重合体をアクリル系共重合体 (A-2)とする。

実施例3

5

10

15

20

$$CH_2 = C$$
 $CH_2 = CH$
 $CH_2 = CH$
 $CH_2 = CH$
 $C=0$
 $C=0$

化合物(6-1)55.38g(50モル%)、化合物(6-2)11.08g(10モル%)、化合物(6-3)33.54g(40モル%)を2ープタノン200gに溶解し、さらにジメチルアゾビスイソプチレート4.59gを投入した単量体溶液を準備し、100gの2ープタノンを投入した1000m1の三ロフラスコを30分窒素パージする。窒素パージの後、反応釜を攪拌しながら80℃に加熱し、事前に準備した上記単量体溶液を滴下漏斗を用いて4時間かけて滴下した。滴下開始を重合開始時間とし、重合反応を6時間実施した。重合終了後、重合溶液は水冷することにより30℃以下に冷却し、2ープロパノール/nーペプタン=1/2の混合溶媒2000gへ投入し、析出した白色粉末を5別する。ろ別された白色粉末を2度2ープロパノール/nーペプタン=1/2の混合溶媒400gにてスラリー上で洗浄した後、ろ別し、50℃にて17時間乾燥し、白色粉末の重合体を得た(65g、収率65%)。この重合体はMwが8200



であり、化合物(6-1)、化合物(6-2)、化合物(6-3)で表される繰り返し単位、各繰り返し単位の含有率が 13 C NMRで測定した結果、53.6:11.0:35.4(モル%)の共重合体であった。この共重合体をアクリル系共重合体(A-3)とする。

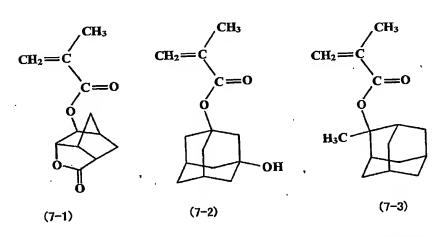
5

10

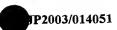
15

20

比較例1



化合物 (7-1) 23.97g (25モル%)、化合物 (7-2) 50.55g (50モル%)、化合物 (7-3) 25.49g (25モル%)とを2ーブタノン200gに溶解し、更にジメチルアゾビスイソブチレート3.97gを投入した単量体溶液を準備し、100gの2ーブタノンを投入した1000mlの三ロフラスコを30分窒素パージする。窒素パージの後、反応釜を攪拌しながら80℃に加熱し、事前に準備した上記単量体溶液を滴下漏斗を用いて3時間かけて滴下した。滴下開始を重合開始時間とし、重合反応を5時間実施した。重合終了後、重合溶液は水冷することにより30℃以下に冷却し、2000gのメタノールへ投入し、析出した白色粉末をろ別する。ろ別された白色粉末を2度400gのメタノールにてスラリー上で洗浄した後、ろ別し、50℃にて17時間乾燥し、白色粉末の重合体を得た(74g、収率74%)。この重合体はMwが9800であり、化合物(7-1)、化合物(7-2)、化合物(7-3)で表される繰り返し単位、各繰り返し単位の含有率が13C NMRで測定した結果、29.2:



45.2:25.6 (モル%) の共重合体であった。この共重合体をメタアクリル系共重合体 (A-4) とする。

実施例4~実施例10、比較例2~比較例3

5 実施例1~実施例3、および比較例1で得られた各重合体と、以下に示す酸発生剤と、他の成分とを表1に示す割合で配合して各感放射線性樹脂組成物溶液を得た。得られた感放射線性樹脂組成物溶液について各種評価を行なった。評価結果を表2に示す。

酸発生剤 (B)

10 (B-1):トリフェニルスルホニウム・ノナフルオローnーブタンスルホネート

(B-2): トリフェニルスルホニウム 2- ビシクロ [2.2.1] ヘプトー 2 - イルー 1 1 2 2 - テトラフルオロエタンスルホネート

酸拡散制御剤(C)

15 (C-1):トリエタノールアミン

(C-2):2-フェニルベンズイミダゾール

(C-3):2,6-ジイソプロピルアニリン

溶剤(D)

(D-1):プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート

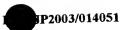
20 (D-2):シクロヘキサノン

(D-3): y-ブチロラクトン

評価方法

(1) 感度1:

25 実施例4~6および比較例2に関して、ArF光源にて露光を行なう場合、ウエハー表面に膜厚78nmのARC29 ((Brewer Science)社製)膜を形成したシリコンウエハー (ARC29)を用い、各組成物溶液を、基板上にスピンコートにより塗布し、ホットプレート上にて、表2に示す条件でPBを行なって形成した膜厚340nmのレジスト被膜に、ニコン社製ArFエキ



シマレーザー露光装置 (開口数 0.55) を用い、マスクパターンを介して露光した。その後、表 2 に示す条件でPEBを行なったのち、2.38重量%のテトラメチルアンモニウムヒドロキシド水溶液により、25℃で60秒間現像し、水洗し、乾燥して、ポジ型のレジストパターンを形成した。このとき、線幅160nmのライン・アンド・スペースパターン (1 L 1 S) を1対1の線幅に形成する露光量を最適露光量とし、この最適露光量を「感度1」とした。

(2) 解像度1:

上記最適露光量で解像される最小のライン・アンド・スペースパターンの寸法を「解像度1」とした。

10 (3) 感度2:

5

実施例 4~6 および比較例 2 に関して、A r F 光源にて露光を行なう場合、ウエハー表面に膜厚 7 8 n mのARC 2 9 ((Brewer Science)社製)膜を形成したシリコンウエハー (ARC 2 9)を用い、各組成物溶液を、基板上にスピンコートにより塗布し、ホットプレート上にて、表 2 に示す条件でPBを行なって形成した膜厚 3 4 0 n mのレジスト被膜に、ニコン社製A r F エキシマレーザー露光装置(開口数 0.55)を用い、マスクパターン(6 %ハーフトーンマスクを使用)を介して露光した。その後、表 2 に示す条件でPEBを行なったのち、2.38重量%のテトラメチルアンモニウムヒドロキシド水溶液により、25℃で60秒間現像し、水洗し、乾燥して、ポジ型のレジストパターンを形成した。このとき、マスクにおいて直径 200 n mのコンタクトホールパターン (1 H 1 S)が直径 160 n mのサイズになるような露光量(マスクバイアス: -40 n m)を最適露光量とし、この最適露光量を「感度 2」とした。

(4)解像度2:

上記最適露光量で解像される最小のコンタクトホールパターンの寸法を「解像 25 度2」とした。

(5) 感度3:

実施例7~10および比較例3に関して、ウエハー表面に77nmのARC2 9A(日産化学社製)膜を形成した基板を用い、組成物を基板上にスピンコート により塗布し、ホットプレート上にて、表2に示す条件でPBを行なって形成し



た膜厚200nmのレジスト被膜に、ニコン社製フルフィールド縮小投影露光装置S306C (開口数0.75)を用い、マスクパターン (6%ハーフトーンマスクを使用)を介して露光した。その後に、表2に示す条件でPEBを行なった後、2.38重量%のテトラメチルアンモニウムヒドロキシド水溶液により、25℃で40秒間現像し、水洗し、乾燥して、ポジ型レジストパターンを形成した。このとき、マスク寸法直径120nmのホールサイズでピッチ220nmのマスクパターンを介して形成したホールパターンが、直径100nmのホールパターンで形成される露光量を最適露光量とし、この最適露光量を「感度3」とした。(6) 感度4およびフロー温度:

実施例7~10および比較例3に関して、ウエハー表面に77nmのARC2 10 9A(日産化学社製)膜を形成した基板を用い、組成物を基板上にスピンコート により塗布し、ホットプレート上にて、表2に示す条件でPBを行なって形成し た膜厚200nmのレジスト被膜に、ニコン社製フルフィールド縮小投影露光装 置S306C(開口数0.75)を用い、マスクパターン(6%ハーフトーンマ スクを使用)を介して露光した。その後に、表2に示す条件でPEBを行なった 15 後、2.38重量%のテトラメチルアンモニウムヒドロキシド水溶液により、2 5℃で40秒間現像し、水洗し、乾燥して、ポジ型レジストパターンを形成した。 この作成したウエハーを更に、140~180℃の範囲で90秒間のポストベー クを実施した。このとき、マスク寸法直径120nmのホールサイズでピッチ2 20 nm、および、ピッチ840 nmのマスクパターンを介して形成したホール 20 パターンが、共に、直径100nmのホールパターンで形成される露光量を最適 露光量とし、この最適露光量を「感度4」とした。また、このときのポストベー クの温度を最適リフロー温度とし、この最適リフロー温度を「フロー温度」とし た。

25 (7) フロー速度1およびフロー速度2:

実施例7~10および比較例3に関して、上記フロー温度に対して、前後10℃の範囲で同様の「感度4」におけるホールパターン直径を測定し、以下の式によりフロー速度を算出した。

フロー速度 (nm/℃) = (A-B) /20℃



ここで、Aは「フロー温度」より 10 \mathbb{C} 高い温度でのホールパターン寸法(nm)であり、Bは「フロー温度」より 10 \mathbb{C} 低い温度でのホールパターン寸法(nm)である。

ピッチ220nmに対するフロー速度を「フロー速度1」とし、ピッチ840 5 nmに対するフロー速度を「フロー速度2」とした。

(8) 放射線透過率:

実施例4~6および比較例2に関して、組成物溶液を石英ガラス上にスピンコートにより塗布し、表2に示した温度条件に保持したホットプレート上で表2に示した条件の間PBを行なって形成した膜厚340nmのレジスト被膜につい

10 て、波長193nmにおける吸光度から、放射線透過率を算出して、遠紫外線領域における透明性の尺度とした。

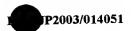
(9) PEB温度依存性1:

実施例 $4\sim6$ および比較例 2 に関して、表 2 の温度条件で感度 1 において 1 6 0 n m の ライン・アンド・スペースを解像する場合、その表 2 の P E B 温度を + 2 \mathbb{C} および - 2 \mathbb{C} 変化させた場合の線幅変動の平均値を D 1 とする。その場合の D 1 が 1 0 n m $/\mathbb{C}$ 以上の場合を不良とし、それ未満の場合を良好とした。

(10) PEB温度依存性2:

実施例 $7 \sim 10$ および比較例 3 に関して、表 2 の温度条件で感度 3 において直径 120 n m のホールパターンを形成する際に、その表 2 の P E B 温度を +2 \mathbb{C} 及び -2 \mathbb{C} 変化させた場合の線幅変動の平均値を D 2 とする。その場合の D 2 が 10 n m $/\mathbb{C}$ 以上の場合を不良とし、それ未満の場合を良好とした。

表1



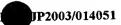
	实施例						比較例		
_					8	9	10	2	3
	4	5	6	7					
掛脂(重量部) A-1	100	_	_	100	100	-	_	-	
A-2		100	-	-	-	100		-	
			100	- 1	-	-	100	-	
A-3				-	-	•		100	100
A-4 酸発生剤(重量部)									
B-1	2.0	2.0	2.0	2.5	1.25	2.5	2.5	2.0	2.0
B-2	_	-	_	-	1.195				
酸拡散制御剤(重量部)		0.0	0,3	_	_	_	-	0.3	0.25
C-1	0.3	0,3	0.3	0.181	0.242	0.181	0.250	-	-
C-2		-		0.055		0.055		_	_
C-3				0.055	 	0.000			
溶剤(重量部)	•		600	850	850	850	850	450	650
D-1	600	600					_	150	230
D-2		 			30	30	30		-
D-3				30	30	30		ـــــــــــال	

表 2

				実施例				比較	例
					В	9	10	2	3
	4	5	6	7					
製膜条件 腹厚(nm)	340	340	340	200	200	200	200	340	200
股序(nm) PB							1	ļ	
温度 (℃)	100	100	100	130	130	130	130	130	130
時間(秒)	90	90	90	90	90	90	90	90	90
PEB		100	100	110	110	110	110	130	130
温度 (℃)	100		90	90	90	90	90	90	90
時間(秒)	90	90	90						
特性評価			_		_	_		69	-
透過率 (%)	70	69	70					292	_
感度 1(J/m²)	243	253	248				 	522	
感度 2(J/m²)	452	472	460					150	
解像度1(nm)	140	140	140				- -	160	
解像度 2(nm)	150	150	160					100	解像世
感度 3(J/m²)		_		384	372	381	321		フローせ
感度 4(J/m²)		-	-	430	473	429	403	<u> </u>	
	 		-	174	174	175	163	↓_	フローせ
フロー温度(℃)	 	-	_	-6.15	-6.17	-6.10	-5.23		フローセ
フロー速度1(nm/°C)	 	 		-6.35	-6.39	-6.36	-5.93	<u> </u>	フローセ
フロー速度2(nm/℃)			良好				-	-	_
PEB温度依存性 1 PEB温度依存性 2	良好	良好	及好	良好	良好	良好	良好	不良	不良

5 産業上の利用可能性

本発明のアクリル系共重合体を用いた感放射線性樹脂組成物は、エッチング耐性、エッチングの表面荒れ耐性が極めて高く、ポストベークによるコンタクトホールサイズの調整できるとともに、ポストベーク温度変動による線幅変動を少な



くできるので、今後さらに微細化が進むと予想される半導体デバイスの製造に極めて好適に使用できる。

請求の範囲

1.下記式(1)、式(2)および式(3)で表される繰り返し単位を含むことを特徴とするアクリル系共重合体。

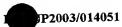
5

10

15

(式 (2) において、Rは水素原子またはメチル基を表し、R¹は相互に独立に水素原子、水酸基、または $-COOR^3$ 基を表し、少なくとも $-OOR^1$ が水素原子ではなく、R³が水素原子あるいは炭素数 $1\sim 4$ の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基、または炭素数 $3\sim 2$ 0の脂環式のアルキル基を表し、式 (3) において、R²は相互に独立に炭素数 $4\sim 2$ 0の1価の脂環式炭化水素基もしくはその誘導体または $1\sim 4$ 0直鎖状もしくは分岐状のアルキル基を表し、かつR²の少なくとも 1つが該脂環式炭化水素基もしくはその誘導体であるか、あるいは何れか 2つの R²が相互に結合して、それぞれが結合している炭素原子とともに炭素数 $4\sim 2$ 0の 2価の脂環式炭化水素基もしくはその誘導体を形成し、残りのR²が炭素数 $1\sim 4$ の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基または炭素数 $4\sim 2$ 0の 1価の脂環式炭化水素基もしくはその誘導体を表す。)

2.アルカリ不溶性またはアルカリ難溶性であって酸の作用によりアルカリ可溶 20 性となる酸解離性基含有樹脂と、感放射線性酸発生剤とを含有する感放射線性樹脂組成物であって、前記酸解離性基含有樹脂が請求項1記載のアクリル系共重合体であることを特徴とする感放射線性樹脂組成物。



- 3. 前記酸解離性基含有樹脂において、少なくとも一つのR¹が水酸基である請求項2記載の感放射線性樹脂組成物。
- 4. 前記酸解離性基含有樹脂において、式(3)中の一C(R²)₃が1ーメチル
 5 ー1ーシクロペンチル基、1ーエチルー1ーシクロペンチル基、1ーメチルー1
 ーシクロヘキシル基、1ーエチルー1ーシクロヘキシル基から選ばれる少なくと
 も一つである請求項2記載の感放射線性樹脂組成物。
- 5. 前記酸解離性基含有樹脂において、前記繰り返し単位(1)、前記繰り返し 10 単位(2)および前記繰り返し単位(3)の配合割合は、全繰り返し単位に対し て、前記繰り返し単位(1)が20~70モル%、前記繰り返し単位(2)が5 ~40モル%、前記繰り返し単位(3)が20~50モル%である請求項2記載 の感放射線性樹脂組成物。
- 15 6. 前記感放射線性酸発生剤がトリフェニルスルホニウム塩化合物、4ーシクロ ヘキシルフェニルジフェニルスルホニウム塩化合物、4ーtーブチルフェニルジ フェニルスルホニウム塩化合物およびトリ(4ーtーブチルフェニル)スルホニウム塩化合物から選ばれた少なくとも一つを含む請求項2記載の感放射線性樹脂組成物。

- 7. 前記感放射線性酸発生剤が、アクリル系共重合体100重量部に対して、0. 1~7重量部含有する請求項2記載の感放射線性樹脂組成物。
- 8. 前記感放射線性樹脂組成物は、さらに酸拡散制御剤が配合され、該酸拡散制 25 御剤として、含窒素有機化合物を含有する請求項2記載の感放射線性樹脂組成物。
 - 9. 放射線照射後に加熱処理、現像後さらにポストベークすることにより、コンタクトホールパターンサイズを精度良く縮小させることができる請求項2記載の感放射線性樹脂組成物。



補正書の請求の範囲

[2004年2月17日 (17. 02. 04) 国際事務局受理:出願当初の請求の範囲 1は補正された:他の請求の範囲は変更なし。(1頁)]

1. (補正後)下記式(1)、式(2)および式(3)で表される繰り返し単位を含むことを特徴とするアクリル系共重合体。

5

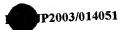
(式 (2) において、Rは水素原子またはメチル基を表し、R¹は相互に独立に水素原子、水酸基、または $-COOR^3$ 基を表し、少なくとも $-cooR^1$ が水素原子ではなく、R³が水素原子あるいは炭素数 $1\sim 4$ の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基、または炭素数 $3\sim 2$ のの脂環式のアルキル基を表し、式 (3) において、R²は何れか 2 つの R^2 が相互に結合して、それぞれが結合している炭素原子とともに炭素数 $4\sim 2$ の 0 2 価の脂環式炭化水素基もしくはその誘導体を形成し、残りの R^2 が炭素数 $1\sim 4$ の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基または炭素

数4~20の1価の脂環式炭化水素基もしくはその誘導体を表す。)

15

10

2. アルカリ不溶性またはアルカリ難溶性であって酸の作用によりアルカリ可溶性となる酸解離性基含有樹脂と、感放射線性酸発生剤とを含有する感放射線性樹脂組成物であって、前記酸解離性基含有樹脂が請求項1記載のアクリル系共重合体であることを特徴とする感放射線性樹脂組成物。



条約19条に基づく説明書



International Cation No.
PCT/JP03/14051

- GT A COT	FICATION OF SUBJECT MATTER				
Int.C	17 C08F220/10, G03F7/039				
According to	International Patent Classification (IPC) or to both natio	nal classification and IPC			
B. FIELDS	SEARCHED	10 11 11			
Int.	cumentation searched (classification system followed by C1 ⁷ C08F20/10-C08F20/28, C08F220				
Electronic da	ata base consulted during the international search (name of	of data base and, where practicable, sear	ch terms used)		
CA (S	TN), REGISTRY (STN)				
C. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT				
Category*	Citation of document, with indication, where appr	ropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.		
P,X	JP 2003-206315 A (Daicel Chem Ltd.), 22 July, 2003 (22.07.03), Claims; Par. Nos. [0045] to [(Family: none)	ical Industries,	1-3,5-7,9		
P,X	JP 2003-43690 A (Fuji Photo E 13 February, 2003 (13.02.03), Claims; Par. Nos. [0024], [016 [0159] to [0175] & KR 2003/35826 A	1-9			
P,X	JP 2002-372784 A (Fuji Photo 26 December, 2002 (26.12.02), Claims; Par. Nos. [0109] to [(Family: none)	1-3,5-9			
× Furt	her documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.			
"A" docur consist "E" earlie date "L" docur cited speci "O" docur mean "P" docur than	ment published prior to the international filing date but later the priority date claimed	priority date and not in conflict with understand the principle or theory undocument of particular relevance; the considered novel or cannot be consicted when the document is taken aloued the considered to involve an inventive stream or combined with one or more other succombination being obvious to a persuscent the combination that the combin	ament of particular relevance; the claimed invention cannot be idered to involve an inventive step when the document is bined with one or more other such documents, such bination being obvious to a person skilled in the art ament member of the same patent family		
09	e actual completion of the international search December, 2003 (09.12.03)	Date of mailing of the international second 24 December, 2003	(24.12.03)		
Name and Jap	mailing address of the ISA/ panese Patent Office	Authorized officer			
Facsimile	No	Telephone No.			

INTERNATIONAL ARCH REPORT

International cation No.
PCT/JP03/14051

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	JP 2002-251013 A (Fuji Photo Film Co., Ltd.), 06 September, 2002 (06.09.02), Claims; Par. Nos. [0165] to [0238], [0262] to [0269], [0274] to [0316] (Family: none)	1-9
X	JP 2002-201232 A (Daicel Chemical Industries, Ltd.), 19 July, 2002 (19.07.02), Full text (Family: none)	1-3,5-9



発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) Α.

Int. Cl. 7 C08F220/10, G03F7/039

調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int. Cl. CO8F20/10-C08F20/28, C08F220/10-C08F220/28, G03F7/039

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)

CA (STN), REGISTRY (STN)

C. 関連する	6と認められる文献	
引用文献の		関連する
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号
PΧ	JP 2003-206315 A (ダイセル化学工業株式会社) 2003.07.22,特許請求の範囲,【0045】-【004	1-3, 5-7, 9
	2003.07.22, 特計請求の配囲, 【0043】 【004 6】, 実施例9(ファミリーなし)	
PX	JP 2003-43690 A (富士写真フイルム株式会社) 2003.02.13, 特許請求の範囲, 【0024】, 【010 1】-【0152】, 【0159】-【0175】 & KR 2003/35826 A	1-9

|X| C欄の続きにも文献が列挙されている。

パテントファミリーに関する別紙を参照。

- * 引用文献のカテゴリー
- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献(理由を付す)
- 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

- の日の後に公表された文献
- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査報告の発送日 国際調査を完了した日 24.12.03 09.12.03 特許庁審査官(権限のある職員) 8619 国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁(ISA/JP) 關 政立 郵便番号100-8915 電話番号 03-3581-1101 内線 3455

様式PCT/ISA/210 (第2ページ) (1998年7月)

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

	国際調査報告	国際出願番号 PCT PO	3/14001
C (続き) .	関連すると認められる文献		
引用文献の		け その関連する笛所の表示	関連する請求の範囲の番号
カテゴリー* PX	引用文献名 及び一部の箇所が関連するとき JP 2002-372784 A (富士 2002.12.26,特許請求の範囲, 1】 (ファミリーなし)	±写真フイルム株式会社)	1-3, 5-9
X.	JP 2002-251013 A (富士 2002.09.06,特許請求の範囲, 8],【0262】-【0269】,【 (ファミリーなし)	[0165] - [023]	1-9
х	JP 2002-201232 A (ダー 2002.07.19,全文 (ファミリー	イセル化学工業株式会社) ーなし)	1-3, 5-9
		·	